



# TECHNONICOL

## PREMIUM



# LOGICPIR

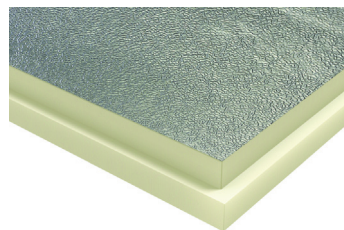
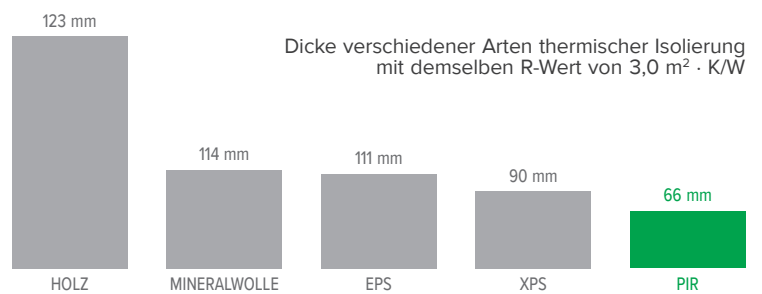
## THERMISCHE DÄMMPLATTE

LOGICPIR ist eine Platte aus festem PIR (Polyisocyanurat) und wird für Flachdachsysteme verwendet. Da sie sehr fest und komplett flach ist, ist LOGICPIR ein idealer Träger für Bedachungsmaterialien, insbesondere für synthetische Membranen. LOGICPIR verfügt über eine hohe Druckfestigkeit und einen sehr niedrigen thermischen Leitfähigkeitswert von  $0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ .

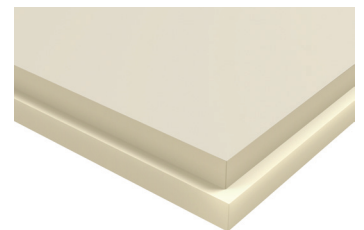
Über 95 % des PIR besteht aus geschlossenen Zellen. PIR-Platten absorbieren kein Wasser. Wichtige Parameter werden

### TECHNISCHE DATEN

Dicke, mm	20-250 in Zehnerschritten
Plattengrößen, mm	1200x600, 2400x1200
Thermische Leitfähigkeit, $\text{W/m}^2\text{K}$	0,022
Brandverhalten	Klasse E
Druckfestigkeit, kPa	120
Langfristige Wasseraufnahmefähigkeit, %	1
Oberflächentyp	Aluminiumfolie oder Glasfasermatte



LOGICPIR mit Aluminium-Oberfläche



LOGICPIR mit Glasfasermatte-Oberfläche

# EINZIGARTIGE MERKMALE VON LOGICPIR



## ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

Über die gesamte Lebensdauer von 25 Jahren bewahrt LOGICPIR seine guten Eigenschaften. Es funktioniert effizient innerhalb eines Temperaturbereiches von  $-65^{\circ}\text{C}$  bis  $+110^{\circ}\text{C}$  und kann somit in jeder beliebigen Klimazone verwendet werden.



## ABSORBIERT KEIN WASSER

Die Plattenstruktur besteht aus geschlossenen starren Zellen, die verhindern, dass Wasser in das Material eindringt. Komposit-Kaschierungen aus AL-Folie und Kunststoff bieten eine zusätzliche Dampfsperre.



## BRENNT NICHT

LOGICPIR ist nicht entflammbar. Kommt es zu einem Kontakt mit offenem Feuer, brennt nur das Polymer an der Oberfläche. Dieses bildet eine Kohleschicht, die einen effektiven Schutz gegen weitere Beschädigungen des Polymers bietet.



## DYNAMISCHER LASTWIDERSTAND

LOGICPIR erfüllt die Anforderungen der Klasse 2 für dynamische Lasten (EN 826). Die Druckfestigkeit von 120 kPa bietet hohen Widerstand gegen Verformungen durch Verkehrslasten.



## NIEDRIGSTE THERMISCHE LEITFÄHIGKEIT

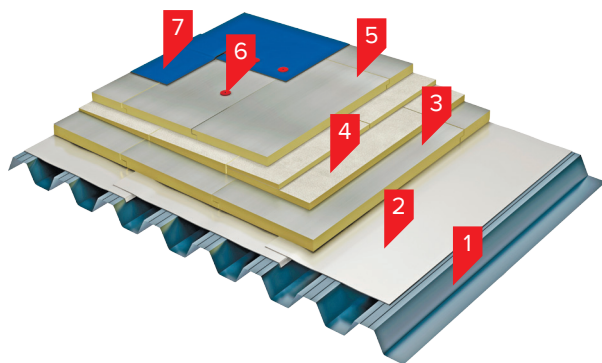
LOGICPIR weist eine sehr niedrige thermische Leitfähigkeit von  $0,022 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$  auf. Platten haben L-förmige Kanten, sodass sie geschmeidig ineinander passen und Kältebrücken verhindern.



## NIEDRIGE DICHTe

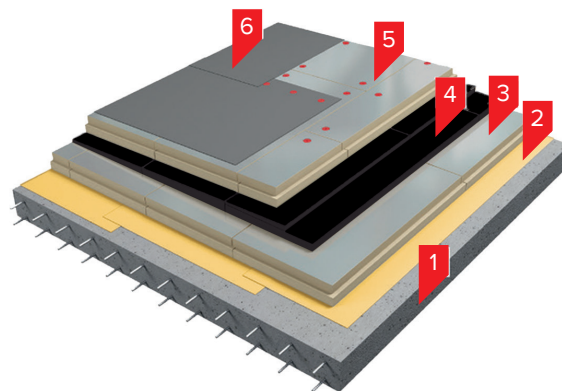
Die niedrige Dichte von LOGICPIR ist gepaart mit einem hohen thermischen Widerstand. Die Verwendung des Produkts verringert das Gesamtgewicht eines Daches. Dies ist besonders bei Dachsanierungen wichtig. Auch die Transportkosten sind geringer.

## BEDACHUNGSSYSTEMEN



### MECHANISCH BEFESTIGTES BEDACHUNGSSYSTEM

1. Wellblech
2. Dampfsperre
3. Thermische LOGICPIR Dämmplatte
4. Thermische LOGICPIR Dämmplatte, geneigt
5. Thermische LOGICPIR Dämmplatte
6. Mechanische Befestigung
7. LOGICROOF V-RP-Membran



### DACHSANIERUNG

1. Bewehrte Beton-Basis
2. Dampfsperre
3. Thermische Dämmung
4. Bituminöse Membran
5. Thermische LOGICPIR Dämmplatte
6. LOGICROOF V-RP-Membran

